

# Indium3.2HF 细间距系统级封装 (SiP) 水洗型焊锡膏

- 细小开孔上的印刷性能出色 (5号粉和6号粉)
- 钢网上使用寿命长
- 印刷暂停响应出色
- 出色的抗塌落性能
- 极佳的细间距可焊性

## 主要使用对象

- 所有主流移动设备的前端模块



[china@indium.com](mailto:china@indium.com)

ISO 9001  
REGISTERED

表格编号: 99643 R0  
©2019 钢泰公司



INDIUM  
CORPORATION®

# 异构集成和组装焊接材料

• 3D 逻辑/记忆体和倒装芯片

• 系统级封装



Wafer Bumping  
(Bump Fusion) 助焊剂

• 盖封MEMS  
点胶型细间距焊锡膏

• BGA  
植球助焊剂

倒装焊助焊剂

晶圆级植球助  
焊剂

超细间距焊  
锡膏

材料类型	材料名称	助焊剂类型	注释
倒装焊助焊剂	WS-446	水洗型	可焊性差情况下的最佳助焊剂, 含卤素
	WS-446HF	水洗型	最佳全能型无卤倒装焊助焊剂, 易清洗
	NC-26-A	免洗、极低残留	与CUF/MUF的兼容性最佳
	NC-26S	免洗、极低残留	避免毛细作用上升到芯片表面, 细间距元件/设备
植球助焊剂	WS-446-AL	水洗型	可焊性差情况下的最佳助焊剂, 含卤素
	WS-575-C	水洗型	去除OSP的预涂助焊剂步骤
	WS-823	水洗型	最佳全能型无卤植球助焊剂, 易清洗
	WS-676	水洗型	用于晶圆上印刷, 适用于WLCSP
	WS-759	水洗型	用于晶圆或基板上印刷, 适用于FOW/PLP
SiP 焊锡膏	Indium3.2HF	水洗型	T6号粉焊锡膏适用于超细间距印刷, 专为01005和更小的分离器件设计
	Indium8.9HF	溶剂清洗、免洗	
	SMQ@75	免洗、极低残留	



[china@indium.com](mailto:china@indium.com)

ISO 9001  
REGISTERED

表格编号: 99643 R0  
©2019 钢泰公司

INDIUM  
CORPORATION